

# 極薄板対応フィルム剥離装置 AUTO PEELER

# ACPM650A

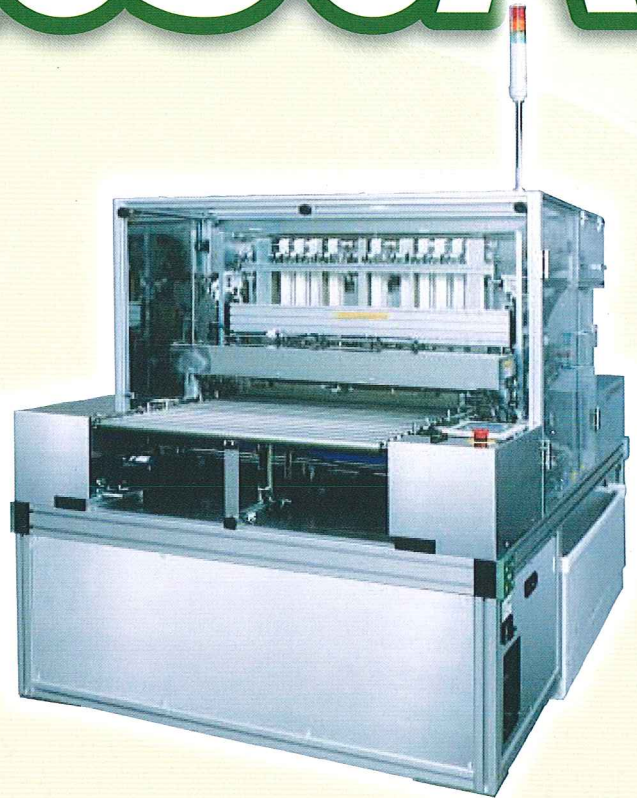
本装置は、現象前プリント基板の、ドライフィルムフォトレジスト表面に貼られた、ポリエステルカバーフィルムを自動的に剥離することを目的とします。

This system automatically peels off the mylar cover-film from dry-film photo resist of the pre-development PC board.

The cover-films on the both sides of the PC board are simultaneously peeled off.

従来の装置では剥離困難であった極薄板(基材厚:0.025mm)も、独自の剥離機構の開発により対応可能としました。

The ACPM650A is capable of peeling mylar film for ultra-thin boards (Board thickness:0.025mm) previously difficult with existing machines.



## 特長 : Features

### 1 クリーンな剥離 : Clean Peeling Off

●エアブローを用いず、粘着ローラーで剥離するため、チップ飛びを軽減できます。

・ Proprietary peeling method using adhesive rollers without any air-blow minimizes the generation of particle contamination from the PCB.

### 2 段取り作業の簡略化 : Simplified set-up

●基板仕様(板厚・サイズ)に対して、段取り換えが不要です。

・ Does not require any set-up between different board sizes and thickness.

### 3 極薄板対応 : Applicable to very thin boards

特許出願中  
PATPEND

## 標準仕様 : Standard specifications

モデル [Model]	ACPM650A	
最小板厚 [Min board thickness]	基材 : 0.025mm以上 銅箔 : 片面9μm以上 (両面必要)	[Plating: 0.025mm or over] [Copper foil: over 9μm for single side (Both sides are needed)]
最大板厚 [Max board thickness]	3.2mm (銅箔、DF含む)	[3.2mm (Included copper and DF)]
適用基板サイズ (川幅×流れ) [Applicable board size (depth×flow)]	MAX 650×650mm MIN 300×250mm	
タクト [Tact time]	15秒 / 枚 [15 sec / board]	
剥離方式 [Method]	粘着ローラー [Adhesive roller]	
補助剥離方式 [Auxiliary method]	横移動式ローレット [Knurled roller, movable side long-wise]	
電源 [Power supply]	200/220VAC3φ 50/60Hz	
重量(本体) [Weight]	500kg	



株式会社 アドテックエンジニアリング

本社 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-5 丸の内北口ビルディング2階  
Head Office Marunouchi Kitaguchi Bldg. 2F, 1-6-5 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005, Japan  
PHONE. 03-6369-9805 FAX. 03-6369-9803

長岡工場 〒940-2311 新潟県長岡市三島新保397番地  
Nagaoka Factory 397 Mishimashinbo, Nagaoka-shi, Niigata 940-2311 Japan  
PHONE. 0258-42-3111(代) FAX. 0258-42-3114

URL <http://www.adtec.com/> / E-mail [sales@adtec-eng.co.jp](mailto:sales@adtec-eng.co.jp)